【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成17年2月24日(2005.2.24)

【公表番号】特表2004-503797(P2004-503797A)
【公表日】平成16年2月5日(2004.2.5)
【年通号数】公開・登録公報2004-005
【出願番号】特願2002-509807(P2002-509807)
【国際特許分類第７版】
　ＧＯ２Ｂ　26/08
　ＧＯ３Ｂ　21/00
【ＦＩ】
　ＧＯ２Ｂ　26/08　　Ｅ
　ＧＯ３Ｂ　21/00　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成15年3月10日(2003.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体基板を含む下部プレート組立部品と、前記下部プレート組立部品上で密閉された上部プレート組立部品とを備え、
前記上部プレート組立部品は、透明カバーと、前記下部プレート組立部品に近づく方向及び離れる方向にばね状に撓むように前記透明カバー上に取り付けられた少なくとも一つのリボン形リフレクタとを含み、前記リボン形リフレクタは、２つの離れた点で前記上部プレート組立部品と結合され、前記リボン形リフレクタは、前記下部プレート組立部品に接触する少なくとも１つの突部を含む、ことを特徴とする位相格子。
【請求項２】
複数のリボン形リフレクタを含む、ことを特徴とする請求項１に記載の位相格子。
【請求項３】
前記基板はシリコン・ダイである、ことを特徴とする請求項１に記載の位相格子。
【請求項４】
前記上部プレート組立部品は前記リボン形リフレクタに接触する階段状部分を含む、ことを特徴とする請求項１に記載の位相格子。
【請求項５】
前記下部プレート組立部品と前記上部プレート組立部品とは取り外し可能な接続で結合されている、ことを特徴とする請求項１に記載の位相格子。
【請求項６】
前記取り外し可能な接続はクランプ接続である、ことを特徴とする請求項５に記載の位相格子。
【請求項７】
前記階段状部分は前記上部プレート組立部品と一体である、ことを特徴とする請求項４に記載の位相格子。
【請求項８】
前記上部プレート組立部品は前記下部プレート組立部品から取り外し可能である、ことを特徴とする請求項１に記載の位相格子。

【請求項９】
前記基板は集積回路である、ことを特徴とする請求項１に記載の位相格子。
【請求項１０】
基板を含む下部プレート組立部品と、前記下部プレート組立部品上で密閉された上部プレート組立部品とを含む位相格子と、
前記位相格子を光照射するための光源と、を備え、
前記上部プレート組立部品は、透明カバーと、前記下部プレート組立部品に近づく方向及び離れる方向にばね状に撓むように前記透明カバー上に取り付けられた少なくとも一つのリボン形リフレクタとを含み、前記リボン形リフレクタは、２つの離れた点で前記上部プレート組立部品と結合され、かつ、前記下部プレート組立部品に接触する少なくとも１つの突部を含む、ことを特徴とするディスプレイ。
【請求項１１】
光学システムを含む、ことを特徴とする請求項１０に記載のディスプレイ。
【請求項１２】
投影ディスプレイである、ことを特徴とする請求項１１に記載のディスプレイ。
【請求項１３】
前記光源からの光を前記位相格子に向けて反射させるように配置されたプリズムを含む、ことを特徴とする請求項１２に記載のディスプレイ。
【請求項１４】
表示スクリーンを含む、ことを特徴とする請求項１２に記載のディスプレイ。
【請求項１５】
半導体基板を含む下部プレート組立部品を形成するステップと、
前記下部プレート組立部品上で密閉された上部プレート組立部品を形成するステップと、
前記下部プレート組立部品と前記上部プレート組立部品とを取り外し可能に結合するステップと、を含み、
前記上部プレート組立部品は、透明カバーと、２つの離れた位置間で前記下部プレート組立部品に近づく方向及び離れる方向にばね状に撓むように、前記２つの離れた位置で前記透明カバー上に取り付けられた少なくとも一つのリボン形リフレクタとを含み、前記リボン形リフレクタが突部を含み、
前記結合するステップでは、前記リボン形リフレクタの突部が下部プレート組立部品に接触する、ことを特徴とする位相格子の製造方法。
【請求項１６】
前記位相格子を使用して表示画像を現像することを含む、ことを特徴とする請求項１５に記載の位相格子の製造方法。
【請求項１７】
前記下部プレート組立部品を前記上部プレート組立部品にクランプすることを含む、ことを特徴とする請求項１５に記載の位相格子の製造方法。
【請求項１８】
前記上部プレート組立部品上の階段状部分を使用して前記上部プレート組立部品を前記下部プレート組立部品から空間的に隔てることを含む、ことを特徴とする請求項１５に記載の位相格子の製造方法。
【請求項１９】
前記基板内に集積回路を画定することを含む、ことを特徴とする請求項１５に記載の位相格子の製造方法。
【請求項２０】
前記基板との間に引力を生じさせることにより前記リボン形リフレクタを撓ませる、ことを特徴とする請求項１５に記載の位相格子の製造方法。